

目次

1. パッケージビジネスの現状と展望

| | |
|--|----|
| 1-1 パッケージビジネスの現状と展望 | 2 |
| 1-1-1 世界半導体産業の売上推移と展望 | 3 |
| 1-1-2 世界半導体後工程市場・世界 OSAT 上位 20 社の売上推移と展望" | 3 |
| 1-1-3 世界パッケージ市場・世界 OSAT 上位 20 社の売上推移と展望" | 4 |
| 1-1-4 世界 OSAT 上位 20 社の売上推移と展望 | 4 |
| 1-1-5 世界 OSAT 上位 20 社の企業別売上一覧 | 5 |
| 1-1-6 世界 OSAT 上位 20 社の国籍別社数構成比 | 6 |
| 1-1-7 世界 OSAT 上位 20 社の国籍別売上構成比 (2024 年度) | 6 |
| 1-2 後工程製造拠点および設備投資状況 | 7 |
| 1-2-1 後工程工場世界分布 (日本を除く) | 8 |
| 1-2-2 世界 OSAT 上位 20 社の後工程工場世界分布(日本を除く)" | 8 |
| 1-2-3 世界半導体設備投資の推移と展望 | 9 |
| 1-2-4 世界半導体後工程設備投資の推移と展望 | 9 |
| 1-2-5 世界 OSAT 上位 20 社の企業別後工程設備投資一覧 | 10 |
| 1-2-6 世界 OSAT 上位 20 社の国籍別設備投資構成比 (2024 年度) | 10 |
| 1-3-1 半導体後工程市場の現状と展望 - 日本 | 11 |
| 1-3-1-1 半導体後工程の企業別売上一覧 - 日本 | 12 |
| 1-3-1-2 半導体後工程の企業別設備投資一覧 - 日本 | 13 |
| 1-3-2 半導体後工程市場の現状と展望 - 台湾 | 14 |
| 1-3-2-1 半導体後工程の企業別売上一覧 - 台湾 | 15 |
| 1-3-2-2 半導体後工程の企業別設備投資一覧 - 台湾 | 16 |
| 1-3-3 半導体後工程市場の現状と展望 - 韓国 | 17 |
| 1-3-3-1 半導体後工程の企業別売上一覧 - 韓国 | 18 |
| 1-3-3-2 半導体後工程の企業別設備投資一覧 - 韓国 | 19 |
| 1-3-4 半導体後工程市場の現状と展望 - 中国 | 20 |
| 1-3-4-1 半導体後工程の企業別売上一覧 - 中国 | 21 |
| 1-3-4-2 半導体後工程の企業別設備投資一覧 - 中国 | 22 |
| 1-3-5 半導体後工程市場の現状と展望 - 東南アジア | 23 |
| 1-3-5-1 半導体後工程の企業別売上一覧 - 東南アジア | 24 |
| 1-3-5-2 半導体後工程の企業別設備投資一覧 - 東南アジア | 25 |
| 1-3-6 半導体後工程市場の現状と展望 - 米国 | 26 |
| 1-3-6-1 半導体後工程の企業別売上一覧 - 米国 | 27 |
| 1-3-6-2 半導体後工程の企業別設備投資一覧 - 米国 | 28 |
| 1-3-7 半導体後工程市場の現状と展望 - 欧州 | 29 |
| 1-3-7-1 半導体後工程の企業別売上一覧 - 欧州 | 30 |
| 1-3-7-2 半導体後工程の企業別設備投資一覧 - 欧州 | 31 |

2. 国内半導体企業のパッケージ事業戦略

| | |
|----------------------|----|
| 2-1 ソニー株式会社 | 34 |
| 1) 事業戦略 | 34 |
| 2) 設備投資 | 35 |
| 3) 開発と今後の方向性 | 36 |
| 4) 半導体売上状況 | 37 |
| 5) 設備投資状況 | 37 |
| 6) 工場別提供パッケージ | 38 |
| 7) 各工場のライン別一覧 | 39 |
| 2-2 ルネサスエレクトロニクス株式会社 | 43 |
| 1) 事業戦略 | 43 |
| 2) 設備投資 | 44 |
| 3) 開発と今後の方向性 | 45 |
| 4) 半導体売上状況 | 46 |

| | |
|------------------------|-----|
| 5) 設備投資状況 | 46 |
| 6) 工場別提供パッケージ | 47 |
| 7) 各工場のライン別一覧 | 48 |
| 2-3 東芝デバイス &ストレージ株式会社 | 56 |
| 1) 事業戦略 | 56 |
| 2) 設備投資 | 57 |
| 3) 開発と今後の方向性 | 57 |
| 4) 半導体売上状況 | 59 |
| 5) 設備投資状況 | 59 |
| 6) 工場別提供パッケージ | 60 |
| 7) 各工場のライン別一覧 | 61 |
| 2-4 ローム株式会社 | 66 |
| 1) 事業戦略 | 66 |
| 2) 設備投資 | 67 |
| 3) 開発と今後の方向性 | 67 |
| 4) 半導体売上状況 - (1) 全社製品別 | 69 |
| 4) 半導体売上状況 - (2) 後工程関連 | 69 |
| 5) 設備投資状況 - (1) 全社製品別 | 70 |
| 5) 設備投資状況 - (2) 後工程関連 | 70 |
| 6) 工場別提供パッケージ | 71 |
| 7) 各工場のライン別一覧 | 72 |
| 2-5 三菱電機株式会社 | 83 |
| 1) 事業戦略 | 83 |
| 2) 設備投資 | 84 |
| 3) 開発と今後の方向性 | 84 |
| 4) 半導体売上状況 | 86 |
| 5) 設備投資状況 | 86 |
| 6) 工場別提供パッケージ | 87 |
| 7) 各工場のライン別一覧 | 88 |
| 2-6 富士電機株式会社 | 96 |
| 1) 事業戦略 | 96 |
| 2) 設備投資 | 96 |
| 3) 開発と今後の方向性 | 97 |
| 4) 半導体売上状況 | 98 |
| 5) 設備投資状況 | 98 |
| 6) 工場別提供パッケージ | 99 |
| 7) 各工場のライン別一覧 | 100 |
| 2-7 ミネベアミツミ株式会社 | 107 |
| 1) 事業戦略 | 107 |
| 2) 設備投資 | 108 |
| 3) 開発と今後の方向性 | 109 |
| 4) 半導体売上状況 | 110 |
| 5) 設備投資状況 | 110 |
| 6) 工場別提供パッケージ | 111 |
| 7) 各工場のライン別一覧 | 112 |
| 2-8 サンケン電気株式会社 | 117 |
| 1) 事業戦略 | 117 |
| 2) 設備投資 | 118 |
| 3) 開発と今後の方向性 | 118 |
| 4) 半導体売上状況 | 120 |
| 5) 設備投資状況 | 120 |
| 6) 工場別提供パッケージ | 121 |
| 7) 各工場のライン別一覧 | 122 |
| 2-9 浜松ホトニクス株式会社 | 128 |
| 1) 事業戦略 | 128 |
| 2) 設備投資 | 128 |
| 3) 開発と今後の方向性 | 129 |
| 4) 半導体売上状況 | 130 |
| 5) 設備投資状況 | 130 |
| 6) 工場別提供パッケージ | 131 |
| 7) 各工場のライン別一覧 | 132 |

Semiconductor Package Business Strategy 2026

| | | | |
|-----------------------|-----|---|-----|
| 2-10 日清紡マイクロデバイス株式会社 | 137 | 1) 事業戦略 | 190 |
| 1) 事業戦略 | 137 | 2) 設備投資 | 192 |
| 2) 設備投資 | 138 | 3) 開発と今後の方向性 | 192 |
| 3) 開発と今後の方向性 | 138 | 4) 半導体売上状況 | 195 |
| 4) 半導体売上状況 | 139 | 5) 設備投資状況 | 195 |
| 5) 設備投資状況 | 139 | 6) 工場別提供パッケージ | 196 |
| 6) 工場別提供パッケージ | 140 | 7) 各工場のライン別一覧 | 197 |
| 7) 各工場のライン別一覧 | 141 | 3-2 Micron Technology | 203 |
| 2-11 コーデンシ株式会社 | 143 | 1) 事業戦略 | 203 |
| 1) 事業戦略 | 143 | 2) 設備投資 | 204 |
| 2) 設備投資 | 144 | 3) 開発と今後の方向性 | 205 |
| 3) 開発と今後の方向性 | 144 | 4) 半導体売上状況 | 206 |
| 4) 半導体売上状況 | 145 | 5) 設備投資状況 | 206 |
| 5) 設備投資状況 | 145 | 6) 工場別提供パッケージ | 207 |
| 6) 工場別提供パッケージ | 146 | 7) 各工場のライン別一覧 | 208 |
| 7) 各工場のライン別一覧 | 147 | 3-3 Texas Instruments | 214 |
| 2-12 セイコーエプソン株式会社 | 151 | 1) 事業戦略 | 214 |
| 1) 事業戦略 | 151 | 2) 設備投資 | 215 |
| 2) 設備投資 | 151 | 3) 開発と今後の方向性 | 216 |
| 3) 開発と今後の方向性 | 152 | 4) 半導体売上状況 | 217 |
| 4) 半導体売上状況 | 153 | 5) 設備投資状況 | 217 |
| 5) 設備投資状況 | 153 | 6) 工場別提供パッケージ | 218 |
| 6) 工場別提供パッケージ | 154 | 7) 各工場のライン別一覧 | 219 |
| 7) 各工場のライン別一覧 | 155 | 3-4 ON Semiconductor | 225 |
| 2-13 新電元工業株式会社 | 158 | 1) 事業戦略 | 225 |
| 1) 事業戦略 | 158 | 2) 設備投資 | 226 |
| 2) 設備投資 | 158 | 3) 開発と今後の方向性 | 227 |
| 3) 開発と今後の方向性 | 159 | 4) 半導体売上状況 | 228 |
| 4) 半導体売上状況 | 160 | 5) 設備投資状況 | 228 |
| 5) 設備投資状況 | 160 | 6) 工場別提供パッケージ | 229 |
| 6) 工場別提供パッケージ | 161 | 7) 各工場のライン別一覧 | 230 |
| 7) 各工場のライン別一覧 | 162 | 3-5 Analog Devices | 241 |
| 2-14 スタンレー電気株式会社 | 169 | 1) 事業戦略 | 241 |
| 1) 事業戦略 | 169 | 2) 設備投資 | 242 |
| 2) 設備投資 | 170 | 3) 開発と今後の方向性 | 242 |
| 3) 開発と今後の方向性 | 170 | 4) 半導体売上状況 | 244 |
| 4) 半導体売上状況 | 171 | 5) 設備投資状況 | 244 |
| 5) 設備投資状況 | 171 | 6) 工場別提供パッケージ | 245 |
| 6) 工場別提供パッケージ | 172 | 7) 各工場のライン別一覧 | 246 |
| 7) 各工場のライン別一覧 | 173 | 3-6 Samsung Electronics | 249 |
| 2-15 デクセリアルズ株式会社 | 177 | 1) 事業戦略 | 249 |
| 1) 事業戦略 | 177 | 2) 設備投資 | 250 |
| 2) 設備投資 | 178 | 3) 開発と今後の方向性 | 251 |
| 3) 開発と今後の方向性 | 178 | 4) 半導体売上状況 | 253 |
| 4) 半導体売上状況 | 179 | 5) 設備投資状況 | 253 |
| 5) 設備投資状況 | 179 | 6) 工場別提供パッケージ | 254 |
| 6) 工場別提供パッケージ | 180 | 7) 各工場のライン別一覧 | 255 |
| 7) 各工場のライン別一覧 | 181 | 3-7 SK Hynix | 259 |
| 2-16 株式会社オリジン | 184 | 1) 事業戦略 | 259 |
| 1) 事業戦略 | 184 | 2) 設備投資 | 260 |
| 2) 設備投資 | 184 | 3) 開発と今後の方向性 | 261 |
| 3) 開発と今後の方向性 | 185 | 4) 半導体売上状況 | 262 |
| 4) 半導体売上状況 | 186 | 5) 設備投資状況 | 262 |
| 5) 設備投資状況 | 186 | 6) 工場別提供パッケージ | 263 |
| 6) 工場別提供パッケージ | 187 | 7) 各工場のライン別一覧 | 264 |
| 7) 各工場のライン別一覧 | 188 | 3-8 TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Corporation) | 267 |
| 3. 海外半導体企業のパッケージ事業戦略 | | 1) 事業戦略 | 267 |
| 3-1 Intel Corporation | 190 | 2) 設備投資 | 268 |
| | | 3) 開発と今後の方向性 | 268 |
| | | 4) 半導体売上状況 | 271 |

| | | | |
|---------------------------|-----|-------------------|-----|
| 5) 設備投資状況 | 271 | 6) 工場別提供パッケージ | 348 |
| 6) 工場別提供パッケージ | 272 | 7) 各工場のライン別一覧 | 349 |
| 7) 各工場のライン別一覧 | 273 | 4-5 エスタカヤ電子工業株式会社 | 353 |
| 3-9 Infineon Technologies | 280 | 1) 事業戦略 | 353 |
| 1) 事業戦略 | 280 | 2) 設備投資 | 353 |
| 2) 設備投資 | 281 | 3) 開発と今後の方向性 | 353 |
| 3) 開発と今後の方向性 | 282 | 4) 半導体売上状況 | 355 |
| 4) 半導体売上状況 | 285 | 5) 設備投資状況 | 355 |
| 5) 設備投資状況 | 285 | 6) 工場別提供パッケージ | 356 |
| 6) 工場別提供パッケージ | 286 | 7) 各工場のライン別一覧 | 357 |
| 7) 各工場のライン別一覧 | 287 | 4-6 株式会社ミスズ工業 | 358 |
| 3-10 STMicroelectronics | 297 | 1) 事業戦略 | 358 |
| 1) 事業戦略 | 297 | 2) 設備投資 | 358 |
| 2) 設備投資 | 298 | 3) 開発と今後の方向性 | 358 |
| 3) 開発と今後の方向性 | 299 | 4) 半導体売上状況 | 359 |
| 4) 半導体売上状況 | 301 | 5) 設備投資状況 | 359 |
| 5) 設備投資状況 | 301 | 6) 工場別提供パッケージ | 360 |
| 6) 工場別提供パッケージ | 302 | 7) 各工場のライン別一覧 | 361 |
| 7) 各工場のライン別一覧 | 303 | 4-7 東洋電子工業株式会社 | 363 |
| 3-11 NXP Semiconductors | 312 | 1) 事業戦略 | 363 |
| 1) 事業戦略 | 312 | 2) 設備投資 | 363 |
| 2) 設備投資 | 313 | 3) 開発と今後の方向性 | 364 |
| 3) 開発と今後の方向性 | 313 | 4) 半導体売上状況 | 365 |
| 4) 半導体売上状況 | 315 | 5) 設備投資状況 | 365 |
| 5) 設備投資状況 | 315 | 6) 工場別提供パッケージ | 366 |
| 6) 工場別提供パッケージ | 316 | 7) 各工場のライン別一覧 | 367 |
| 7) 各工場のライン別一覧 | 317 | 4-8 大津電子株式会社 | 368 |

4. 国内 OSAT 企業のパッケージ事業戦略

| | | | |
|---------------------|-----|--|-----|
| 4-1 アオイ電子株式会社 | 322 | 1) 事業戦略 | 368 |
| 1) 事業戦略 | 322 | 2) 設備投資 | 368 |
| 2) 設備投資 | 323 | 3) 開発と今後の方向性 | 368 |
| 3) 開発と今後の方向性 | 323 | 4) 半導体売上状況 | 369 |
| 4) 半導体売上状況 | 324 | 5) 設備投資状況 | 369 |
| 5) 設備投資状況 | 324 | 6) 工場別提供パッケージ | 370 |
| 6) 工場別提供パッケージ | 325 | 7) 各工場のライン別一覧 | 371 |
| 7) 各工場のライン別一覧 | 326 | 4-9 九州日誠電氣株式会社 | 372 |
| 4-2 新光電気工業株式会社 | 332 | 1) 事業戦略 | 372 |
| 1) 事業戦略 | 332 | 2) 設備投資 | 372 |
| 2) 設備投資 | 333 | 3) 開発と今後の方向性 | 372 |
| 3) 開発と今後の方向性 | 333 | 4) 半導体売上状況 | 373 |
| 4) 半導体売上状況 | 334 | 5) 設備投資状況 | 373 |
| 5) 設備投資状況 | 334 | 6) 工場別提供パッケージ | 374 |
| 6) 工場別提供パッケージ | 335 | 7) 各工場のライン別一覧 | 375 |
| 7) 各工場のライン別一覧 | 336 | 4-10 株式会社野田市電子 | 376 |
| 4-3 株式会社加藤電器製作所 | 337 | 1) 事業戦略 | 376 |
| 1) 事業戦略 | 337 | 2) 設備投資 | 376 |
| 2) 設備投資 | 338 | 3) 開発と今後の方向性 | 376 |
| 3) 開発と今後の方向性 | 338 | 4) 半導体売上状況 | 377 |
| 4) 半導体売上状況 | 339 | 5) 設備投資状況 | 377 |
| 5) 設備投資状況 | 339 | 6) 工場別提供パッケージ | 378 |
| 6) 工場別提供パッケージ | 340 | 7) 各工場のライン別一覧 | 379 |
| 7) 各工場のライン別一覧 | 341 | | |
| 4-4 エムテックススマツムラ株式会社 | 345 | | |
| 1) 事業戦略 | 345 | 5-1 ASE (Advanced Semiconductor Engineering) | 382 |
| 2) 設備投資 | 346 | 1) 事業戦略 | 382 |
| 3) 開発と今後の方向性 | 346 | 2) 設備投資 | 383 |
| 4) 半導体売上状況 | 347 | 3) 開発と今後の方向性 | 384 |
| 5) 設備投資状況 | 347 | 4) 半導体売上状況 | 386 |

5. 海外 OSAT 企業のパッケージ事業戦略

| | | | |
|--------------|-----|---------------|-----|
| 1) 事業戦略 | 345 | 5) 設備投資状況 | 386 |
| 2) 設備投資 | 346 | 6) 工場別提供パッケージ | 387 |
| 3) 開発と今後の方向性 | 346 | | |
| 4) 半導体売上状況 | 347 | | |
| 5) 設備投資状況 | 347 | | |

Semiconductor Package Business Strategy 2026

| | | | |
|--|-----|---|-----|
| 7) 各工場のライン別一覧 | 388 | 4) 半導体売上状況 | 529 |
| 5-2 Amkor Technology | 413 | 5) 設備投資状況 | 529 |
| 1) 事業戦略 | 413 | 6) 工場別提供パッケージ | 530 |
| 2) 設備投資 | 414 | 7) 各工場のライン別一覧 | 531 |
| 3) 開発と今後の方向性 | 415 | 5-10 Chipbond Technology | 536 |
| 4) 半導体売上状況 | 418 | 1) 事業戦略 | 536 |
| 5) 設備投資状況 | 418 | 2) 設備投資 | 537 |
| 6) 工場別提供パッケージ | 419 | 3) 開発と今後の方向性 | 538 |
| 7) 各工場のライン別一覧 | 420 | 4) 半導体売上状況 | 539 |
| 5-3 JCET Group | 441 | 5) 設備投資状況 | 539 |
| 1) 事業戦略 | 441 | 6) 工場別提供パッケージ | 540 |
| 2) 設備投資 | 442 | 7) 各工場のライン別一覧 | 541 |
| 3) 開発と今後の方向性 | 443 | 5-11 SFA Semicon | 549 |
| 4) 半導体売上状況 | 445 | 1) 事業戦略 | 549 |
| 5) 設備投資状況 | 445 | 2) 設備投資 | 550 |
| 6) 工場別提供パッケージ | 446 | 3) 開発と今後の方向性 | 550 |
| 7) 各工場のライン別一覧 | 447 | 4) 半導体売上状況 | 552 |
| 5-4 Tongfu Microelectronics (通富微電子) | 454 | 5) 設備投資状況 | 552 |
| 1) 事業戦略 | 454 | 6) 工場別提供パッケージ | 553 |
| 2) 設備投資 | 455 | 7) 各工場のライン別一覧 | 554 |
| 3) 開発と今後の方向性 | 456 | 5-12 Nepes | 557 |
| 4) 半導体売上状況 | 457 | 1) 事業戦略 | 557 |
| 5) 設備投資状況 | 457 | 2) 設備投資 | 558 |
| 6) 工場別提供パッケージ | 458 | 3) 開発と今後の方向性 | 559 |
| 7) 各工場のライン別一覧 | 459 | 4) 半導体売上状況 | 560 |
| 5-5 Powertech Technology | 469 | 5) 設備投資状況 | 560 |
| 1) 事業戦略 | 469 | 6) 工場別提供パッケージ | 561 |
| 2) 設備投資 | 470 | 7) 各工場のライン別一覧 | 562 |
| 3) 開発と今後の方向性 | 471 | 5-13 Formosa Advanced Technologies (FATC) | 568 |
| 4) 半導体売上状況 | 473 | 1) 事業戦略 | 568 |
| 5) 設備投資状況 | 473 | 2) 設備投資 | 569 |
| 6) 工場別提供パッケージ | 474 | 3) 開発と今後の方向性 | 569 |
| 7) 各工場のライン別一覧 | 475 | 4) 半導体売上状況 | 570 |
| 5-6 Tianshui Huatian Technology (TSHT) | 487 | 5) 設備投資状況 | 570 |
| 1) 事業戦略 | 487 | 6) 工場別提供パッケージ | 571 |
| 2) 設備投資 | 488 | 7) 各工場のライン別一覧 | 572 |
| 3) 開発と今後の方向性 | 489 | 5-14 Carsen | 573 |
| 4) 半導体売上状況 | 490 | 1) 事業戦略 | 573 |
| 5) 設備投資状況 | 490 | 2) 設備投資 | 574 |
| 6) 工場別提供パッケージ | 491 | 3) 開発と今後の方向性 | 574 |
| 7) 各工場のライン別一覧 | 492 | 4) 半導体売上状況 | 576 |
| 5-7 UTAC | 502 | 5) 設備投資状況 | 576 |
| 1) 事業戦略 | 502 | 6) 工場別提供パッケージ | 577 |
| 2) 設備投資 | 503 | 7) 各工場のライン別一覧 | 578 |
| 3) 開発と今後の方向性 | 504 | 5-15 OSE (Orient Semiconductor Electronics) | 581 |
| 4) 半導体売上状況 | 506 | 1) 事業戦略 | 581 |
| 5) 設備投資状況 | 506 | 2) 設備投資 | 582 |
| 6) 工場別提供パッケージ | 507 | 3) 開発と今後の方向性 | 582 |
| 7) 各工場のライン別一覧 | 508 | 4) 半導体売上状況 | 583 |
| 5-8 ChipMOS Technologies | 517 | 5) 設備投資状況 | 583 |
| 1) 事業戦略 | 517 | 6) 工場別提供パッケージ | 584 |
| 2) 設備投資 | 517 | 7) 各工場のライン別一覧 | 585 |
| 3) 開発と今後の方向性 | 518 | 5-16 Walton Advanced Engineering | 586 |
| 4) 半導体売上状況 | 520 | 1) 事業戦略 | 586 |
| 5) 設備投資状況 | 520 | 2) 設備投資 | 587 |
| 6) 工場別提供パッケージ | 521 | 3) 開発と今後の方向性 | 587 |
| 7) 各工場のライン別一覧 | 522 | 4) 半導体売上状況 | 588 |
| 5-9 HANA Micron | 526 | 5) 設備投資状況 | 588 |
| 1) 事業戦略 | 526 | 6) 工場別提供パッケージ | 589 |
| 2) 設備投資 | 527 | 7) 各工場のライン別一覧 | 590 |
| 3) 開発と今後の方向性 | 528 | 5-17 China Wafer Level CSP | 596 |

| | |
|----------------------------------|-----|
| 1) 事業戦略 | 596 |
| 2) 設備投資 | 597 |
| 3) 開発と今後の方向性 | 597 |
| 4) 半導体売上状況 | 598 |
| 5) 設備投資状況 | 598 |
| 6) 工場別提供パッケージ | 599 |
| 7) 各工場のライン別一覧 | 600 |
| 5-18 Suzhou Good-Ark Electronics | 602 |
| 1) 事業戦略 | 602 |
| 2) 設備投資 | 603 |
| 3) 開発と今後の方向性 | 603 |
| 4) 半導体売上状況 | 604 |
| 5) 設備投資状況 | 604 |
| 6) 工場別提供パッケージ | 605 |
| 7) 各工場のライン別一覧 | 606 |
| 5-19 Signetics | 610 |
| 1) 事業戦略 | 610 |
| 2) 設備投資 | 610 |
| 3) 開発と今後の方向性 | 611 |
| 4) 半導体売上状況 | 612 |
| 5) 設備投資状況 | 612 |
| 6) 工場別提供パッケージ | 613 |
| 7) 各工場のライン別一覧 | 614 |